# 证券简称：灿芯股份 证券代码：688691

# 灿芯半导体（上海）股份有限公司

# 投资者关系活动记录表

# 编号：2025-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称** | 广发基金、景顺长城基金、国联安基金、中欧基金、易方达基金、太平养老、申万菱信基金、华商基金、国投瑞银基金、中银基金、中金公司、招商基金、国联基金、诺安基金、友邦人寿、汐泰投资、淳厚基金、太保资产、鹏华基金、紫阁投资、星石投资、国华兴益保险、钦沐资产、沣谊投资、润邦投资、朱雀基金、浙商资管、泉果基金、青骊投资、喜世润投资、光大证券、国泰海通证券、上海证券、中泰证券、国信证券、东吴证券、山西证券、国泰海通资管、华泰证券、中邮证券、华鑫证券 |
| **时间** | 2025年9月18日-2025年9月19日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司**  **接待人员姓名** | 董事长、总经理庄志青先生  董事会秘书沈文萍女士  证券事务代表石啸天、梁砚卿 |
| **投资者关系**  **活动主要内容**  **介绍** | 公司情况简要介绍：  灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。  依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、汽车电子、智慧城市等行业。公司凭借技术和服务的优异表现，获得了“中国半导体创新产品和技术奖”、“中国半导体市场最佳设计企业奖”、“上海市浦东新区科学技术奖”、“2025中国IC设计成就奖之年度优秀IC设计服务公司”等多项荣誉奖项。  2025年1-6月，公司实现营业收入28,179.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,088.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,005.56万元。  受客户需求波动影响，公司2025年上半年度营业收入同比有所下降，但一方面公司芯片设计业务收入同比呈现增长趋势，且本报告期完成流片验证的项目数量亦同比增长，为公司后续量产业务收入奠定了基础；另一方面公司2025年第二季度芯片量产业务收入环比增长24.80%，呈现改善态势。同时公司出于长远发展考虑，报告期内持续围绕“IP＋平台”开展研发工作，在高速接口IP、高性能模拟IP及系统级芯片平台方面持续取得研发进展，研发费用同比增长43.25%。  投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：  1、公司2025年1-6月的营业收入变动原因？  答：公司芯片设计业务实现收入14,165.27万元，较去年同期增加30.13%，主要系本报告期内公司完成部分项目规模较大的芯片设计项目，同时公司整体流片项目数量亦保持增长，从而带动公司芯片设计业务收入快速增长。公司2025年1-6月完成流片验证的项目数量为130个，同比增加80.56%。芯片量产业务实现收入14,014.62万元，较去年同期下降71.11%，主要系去年同期对公司量产业务贡献较大的部分客户因其需求变动减少对公司采购，同时公司新增项目收入尚不足以弥补前述收入变动影响所致。与此同时，公司芯片量产业务收入环比已有所回升，2025年第二季度芯片量产业务收入环比增长24.80%，呈现改善态势。  2、公司2025年上半年在一站式芯片定制服务方面取得了哪些进展？  答：公司致力于为下游客户提供高价值、差异化的一站式芯片定制服务，借助公司自身在工艺、自主IP及SoC核心技术方面的优势，公司与业内知名的系统厂商和芯片设计企业开展合作，持续提升公司竞争力。  2025年1-6月，公司提供芯片设计服务的用于国产测试机台的芯片成功流片，该芯片MPW版本一次成功，达到客户机台测试数字芯片的需要。公司提供芯片设计服务的智能网络芯片在特殊工艺平台上进行设计实现，是公司在此工艺平台上的首个项目，且该项目设计规模大、设计难度高，为公司工程定制服务业务历史上子模块数量最多的项目。公司提供芯片设计服务的单点LED驱动芯片目前已通过第一次MPW功能验证，预计将于年内NTO流片。该芯片具有较大的市场需求，后续有望为公司贡献持续的量产业务收入。此外，公司提供芯片设计服务的MRAM控制芯片项目持续推进，预计将于年内流片。该芯片基于SMIC 55LL工艺进行逻辑控制设计，实现了国产MRAM存储的突破，该芯片预计后续将进行多次迭代，具有较大的商业化前景。  3、公司目前在IP研发方面的情况如何？  答：公司围绕高速接口IP和高性能模拟IP开展研发工作。在高速接口IP领域，公司上半年度取得的主要研发进展如下：  （1）DDR：公司基于28nm HKC+工艺的72bit DDR、LPDDR IP设计验证成功，最高速率达到2,667Mbps，已实现量产交付；基于28nm HKD 2.5V工艺的DDR、LPDDR IP设计验证成功,最高速率达到2,667Mbps；基于22nm工艺平台的DDR5 IP完成架构验证，DDR5 IP核技术是支撑新一代高性能计算芯片的关键模块，主要涵盖控制器、PHY物理层及完整子系统解决方案。  （2）SerDes与PCIe：公司基于28nm HKD 1.8V工艺的16Gbps SerDes IP及PCIe 4 IP设计完成进入验证阶段；公司已开展基于28nm工艺平台的28Gbps SerDes IP的设计开发工作并即将进入流片验证阶段，重点布局高速互连技术储备，未来将用于25Gbps以上以太网物理层芯片及车载高速视频传输芯片等领域。  （3）MIPI：公司基于28nm HKD 1.8V工艺的4.5Gbps MIPI DPHY IP设计完成进入验证阶段。  （4）PSRAM：公司基于28nm HKD 2.5V工艺的PSRAM IP实现客户交付。  （5）TCAM：公司基于28nm HKC+工艺TCAM IP设计验证成功，最高速率可达到900MHz。  在高性能模拟IP领域，公司上半年度取得的主要研发进展如下：  （1）ADC：公司基于28nm HKD 1.8V工艺12bit SAR ADC IP设计验证成功，最高采样率达到125Msps，有效位达到10bit以上。基于40nm LL工艺16bit ADC的成功经验，针对40nm EF工艺平台进行IP的性能提升与优化设计已经完成，进入硅验证阶段。  （2）PLL：公司基于28nm HKD 1.8V工艺的PLL IP设计验证成功；基于28nm HKD 2.5V工艺 PLL IP设计验证成功，最高速率达到4.5GHz，并实现客户交付。  （3）PMU：公司基于40nm EF工艺的宽压低功耗电源管理IP平台设计完成进入验证阶段。  4、公司目前在车规芯片、人工智能等新兴领域的进展情况？  答：在车规芯片方面，公司自研的车规MCU平台在2025年上半年度已经MPW回片，并完成点亮测试和基本功能验证，验证结果正常并达到平台研发预期。该平台采用双核设计，通过冗余核、ECC内存、故障自检（BIST）等机制保证了芯片性能，同时通过锁步核（Lockstep Core）实时比对运算结果从而检测硬件故障提供了安全保障。总体而言，公司自研的车规MCU平台具有高性能、强稳定性、多重数据保护能力、高实时性、外设接口丰富等特点，上述特点亦使得其能够适用于多个应用场景，包括动力控制总成（如新能源车的电机控制、燃油车的燃油喷射控制等），底盘系统（如电子稳定程序、主动悬架控制等），传感器融合等。依托公司在车规MCU方面的投入、丰富的自有IP以及芯片定制方面的项目经验和技术优势，公司未来能够满足汽车电子领域不同客户的多样性需求，强化公司在该领域的核心竞争力。  在人工智能、数据中心及智能汽车等领域的强劲需求驱动下，高速接口IP技术正加速迭代，成为芯片设计的核心支撑之一。公司基于28HKC+工艺平台的DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB等高速接口IP已完成验证并实现量产交付，能够为数据中心AI加速芯片、车载SoC等高性能场景需求提供支持，同时上述IP集成先进信号完整性（SI）和电源完整性（PI）设计，能够提升IP在复杂电磁环境下的可靠性。在28HKD工艺平台上，全线DDR、SerDes、PCIe、MIPI、USB等高速接口IP完成客户小批量验证，新增的PSRAM和EMMC IP产品线进一步补充了公司在低功耗存储接口领域的布局。公司基于22nm工艺平台的DDR5 IP完成架构验证，DDR5 IP核技术是支撑新一代高性能计算芯片的关键模块，主要涵盖控制器、PHY物理层及完整子系统解决方案，通过高速率、低功耗及创新架构设计，已深度融入AI计算、数据中心、移动终端及工业控制等高性能领域。  5、公司对未来发展的展望？  答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括：  （1）技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。  （2）市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电子、端侧AI、AI+IoT等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。  （3）研发团队建设与管理效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培训计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本  （4）并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2025年9月18日、2025年9月19日 |
| **关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明** | 无 |